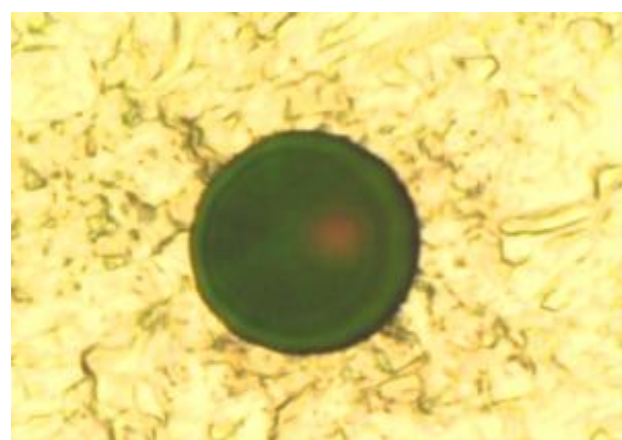


APPLICATION LETTER

●SUS (t=50 μ m) への微細多孔加工



×50倍



×500倍

<加工概要>

t=0.05mmのSUS304に出口径 Φ 0.035、ピッチ0.35mm、位置精度 \pm 0.005mm以下の貫通多孔加工（約15000孔）致しました。

<加工技術の説明>

SUSに対し従来のレーザー加工では熱によるバリやドロスなど溶融物が発生致します。

また0.5mm以下の厚みですと蓄積熱による材料全体の歪みなども発生致します。

当社では熱影響が非常に少ない短パルスレーザーで加工する事により熱歪みを解消した微細多孔加工を可能としました。

またバリやドロスなどの溶融物の発生が無い為、洗浄工程（次工程）の簡略化が可能です。

<当社のレーザー加工の特徴>

1. 高い孔径精度、位置精度を確保した孔加工が可能です。
2. 熱影響が小さく、金属に対しバリ、ドロスなどの溶融物が発生致しません。
3. 光学系の組み合わせによりストレート孔、テーパ孔と任意の孔形状が選択可能です。
4. バリの無いシャープエッジの孔加工が可能です。
5. アスペクト比10倍以上の加工も可能です。（※注 材料と形状によります）



L.P.S.Works

株式会社リプス・ワークス

〒144-0033 東京都大田区東糀谷 6-4-17

OTAテクノCORE 409号室

TEL 03-3745-0330 FAX 03-3745-0331

<http://www.lps-works.com>

E-mail sales@lps-works.com